

## ●日本スペリア社

実装プロセス展で  
アルコナノ銀PR

(株)日本スペリア社(大阪府吹田市江坂町1-16-15、☎06-6380-1121)は、6月9日まで東京ビッグサイトで開催される実装プロセステクノロジー展で、次世代デバイス用の接合材料「アルコナノ

銀ペースト」(写真)を出展している。高耐熱性や熱伝導性などの特性を武器に、SiCパワー半導体やハイパワーLEDなどの用途向けにPRする。

アルコナノ銀ペーストは銀ナノ粒子を溶剤に安定分散させた新たな接合材料で、250℃での接合が可能なことに加えて、熱負荷による強度劣化の抑制や長



期信頼性に優れている。また、特有の還元作用により、未処理の銅基材への直接接合が可能だ。従来のはんだ材料では困難だった、SiCパワー半導体、熱電素子

や車載ヘッドライト用のハイパワーLEDなどの接合に適しており、これらのデバイスの高性能化に貢献できる。16年には津山工場(岡山県津山市)に量産ラインを整備した。

同展示会では、アルコナノ銀ペーストに加え、耐熱負荷を向上した鉛フリーはんだや長期の接合強度維持が可能なアルミ接合用はんだなどの製品を紹介する。高温や長期信頼性ニーズへの対応力の高さをPRし、採用拡大を目指す。